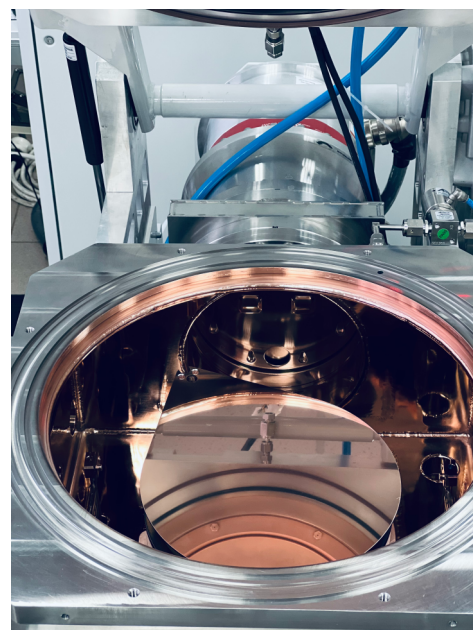


МАГНА ТМ 200-04

Нанесение магнетронным распылением алюминиевой (Al) металлизации, формирование адгезионных, барьерных (Ta/TaN, Ti/TiN) и зародышевых медных (Cu) слоев для перемычек в контактных и переходных отверстиях межслойных соединений и др.



Технические характеристики

- Обработка пластин на рабочем столе: Ø 150, 200мм (Ø 76, 100мм опционально);
- Транспортная система переноса пластин на основе манипулятора;
- Различные варианты исполнения системы загрузки: шлюзовая, из кассеты в кассету, SMIF контейнер;
- ВЧ рабочий стол с вертикальным перемещением, поддержкой температуры в диапазоне -20...+250°C, подачей аргона под пластину и прижимом;
- Магнетронное распылительное устройство с вращающейся магнитной системой;
- Предусмотрен режим нанесения пленок из мишени Ø 300мм в импульсном режиме, DC мощность до 20 кВт для заполнения глубоких канавок и щелей в изделиях (SIP);
- Механическая заслонка для защиты рабочей поверхности пластины;
- Система прогрева стенок рабочей камеры до +120°C;
- Сменные экраны для предотвращения запыления рабочей камеры;
- Скорость нанесения:
 - Cu не менее 2 мкм/мин;
 - TiN не менее 1,5 мкм/мин;
 - Al не менее 1 мкм/мин;
- Возможность встраивания в кластер и в чистую комнату.

